

**РАСЧЕТ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО ВОЛЬТАМПЕРНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КРЕМНИЕВОГО МОП-ТРАНЗИСТОРА
С ДЛИНОЙ КАНАЛА 50 НМ**

Д. В. Поздняков, А. В. Борзов, В. М. Борзов

Белорусский государственный университет, pozdnyakov@bsu.by

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время из-за продолжающейся миниатюризации приборных структур кремниевой наноэлектроники особенно острой стала проблема адекватного моделирования их функционирования. Это связано, в первую очередь, с тем, что разработанные для нужд микроэлектроники программные средства имеют размерные ограничения по параметрам, обусловленные использованием при создании этих средств различного рода приближений и упрощений в описании процесса переноса электронов. В результате, исключительно большое внимание стало уделяться расчетам электрических характеристик кремниевых наноприборов из первых принципов. Одним из методов, позволяющих проводить такие расчеты, является многочастичный метод Монте-Карло. Используемый в этом методе физико-математический аппарат фактически дает возможность проводить имитационный численный эксперимент, эквивалентный реальному физическому эксперименту, и отслеживать тончайшие физические эффекты. В связи с этим, целью настоящей работы стали, с одной стороны, расчет многочастичным методом Монте-Карло вольтамперных характеристик (ВАХ) кремниевого МОП-транзистора с длиной канала 50 нм и, с другой стороны, исследование влияния на эти ВАХ таких доминирующих в подобныхnanoструктурах механизмов рассеяния, как рассеяние носителей заряда на плазонах, ионизированных атомах легирующей примеси и неоднородностях границы раздела Si/SiO₂ в подзатворной области [1–3].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В свое время в работах [4, 5] было теоретически исследовано влияние квантово-размерных эффектов на ВАХ кремниевого МОП-транзистора с длиной канала 50 нм. Как установили авторы этих работ, учет такого рода эффектов влечет за собой заметное уменьшение тока насыщения стока. Начальный участок ВАХ остается практически без изменений. Однако в работах [4, 5] не учитывались такие важные механизмы рассеяния, как рассеяние электронов на плазонах, примесных ионах и неоднородностях (неровностях или, как их еще называют, шероховатостях) границы раздела Si/SiO₂ в подзатворной области проводящего канала транзистора. Более того, сами авторы данных работ подчеркнули, что, в частности, рассеяние носителей заряда примесными ионами должно практически полностью нивелировать квантоворазмерные эффекты. И при определенных, достаточно больших уровнях легирования кремния можно ожидать отсутствия заметного влияния этих эффектов на ВАХ МОП-транзистора. В результате, за прототип нами был взят кремниевый МОП-транзистор с длиной канала 50 нм, аналогичный тому, что изучался в работах [4, 5]. Его схематический вид представлен на рис. 1.

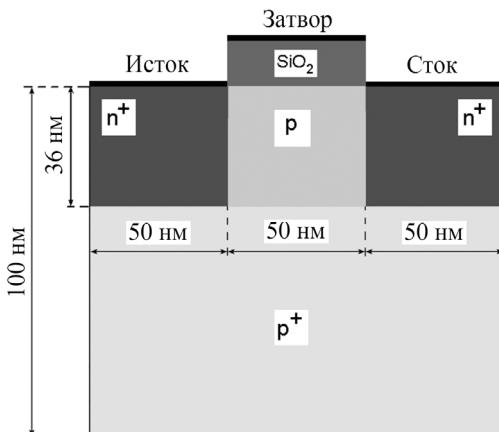


Рис.1. Схематический вид моделируемого МОП-транзистора

Толщина SiO_2 полагалась равной 10 нм. Уровни легирования брались следующие: $N_D = 10^{25} \text{ м}^{-3}$ для n^+ -областей, $N_A = 5 \cdot 10^{23} \text{ м}^{-3}$ для p -области и $N_A = 10^{24} \text{ м}^{-3}$ для p^+ -области. Считалось, что затворный электрод изготовлен из алюминия, а истоковый и стоковый электроды изготовлены из материала, обеспечивающего идеальный омический контакт этих электродов с n^+ -областями кремния.

При расчете ВАХ исследуемого трехэлектродного транзистора многочастичным методом Монте-Карло моделировался ансамбль электронов из 250000 частиц. Для дырок использовалось квазиволновое приближение. Рассматривались

X- и L-долины кремния с учетом непарabolicности. Квантоворазмерные эффекты не учитывались. Наряду с рассеянием электронов на акустических и оптических фонах [1–5] учитывалось их рассеяние на плазонах в рамках описанной в [1] модели. Рассеяние электронов на примесных ионах учитывалось в рамках разработанной в [6] модели, но с использованием приближения экранированного кулоновского потенциала иона ионами, а не электронами. Рассеяние электронов на неоднородностях границы раздела Si/SiO_2 в подзатворной области рассматривалось в рамках классической модели их диффузного отражения от поверхности [3] с долей диффузно отраженных частиц равной 0.4. Доля зеркально отраженных электронов составляла, соответственно, 0.6.

На рис. 2 представлены результаты расчета ВАХ моделируемого транзистора. Приняты следующие обозначения: V_D — напряжение на стоке относительно истока, V_G — напряжение на затворе относительно истока, I_D — ток стока. Сплошные кривые — $V_G = 1.4$ В. Штриховые кривые — $V_G = 1$ В. Кривые 1 — расчет без учета рассеяния электронов на плазонах, примесных ионах и неоднородностях границы раздела Si/SiO_2 . Кривые 2 — расчет с учетом соответствующих механизмов рассеяния. Кривые 3 — расчет с помощью программы Atlas программного комплекса Silvaco в рамках диффузионно-дрейфового приближения.

Из рис. 2 следует, что учтенные механизмы рассеяния электронов оказывают значительное влияние на ВАХ рассматриваемого МОП-транзистора. Тот факт, что начальные участки ВАХ, рассчитанных методом Монте-Карло, почти совпали с начальными участками ВАХ, рассчитанных с помощью программного комплекса Silvaco, подтверждает адекватность использованных нами моделей, поскольку при малых напряжениях на стоке в канале транзистора всегда устанавливается режим диффузионно-дрейфового переноса электронов независимо от длины его канала [3].

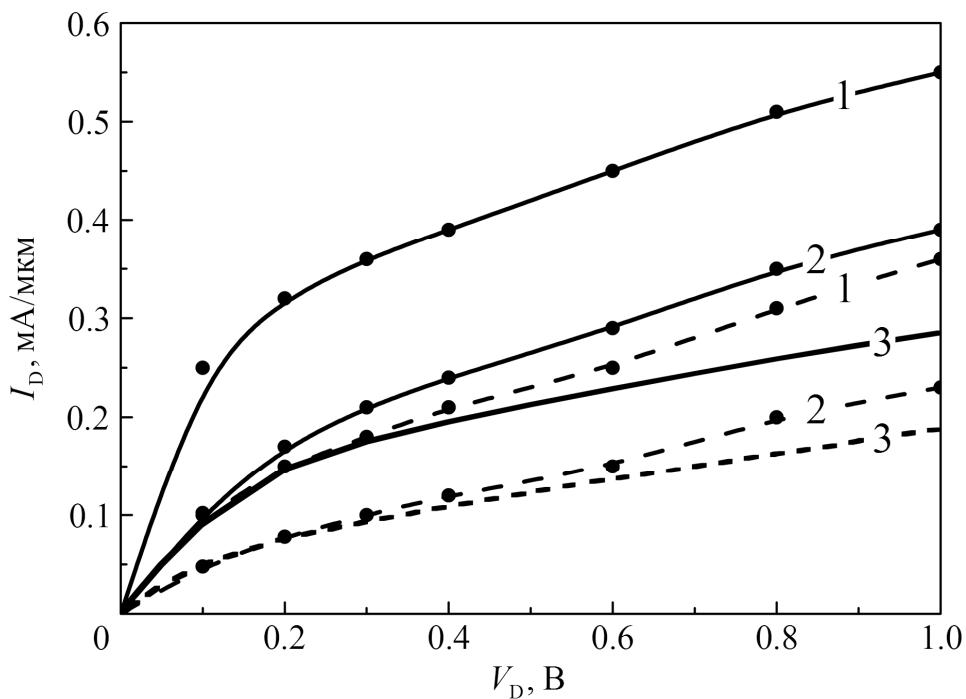


Рис.2. ВАХ моделируемого МОП-транзистора при комнатной температуре

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассчитаны методом Монте-Карло ВАХ кремниевого МОП-транзистора с длиной канала 50 нм. Исследовано влияние на эти ВАХ рассеяния электронов на плазонах, примесных ионах и шероховатостях границы Si/SiO₂. Установлено, что это влияние настолько значительно, что пренебрежение соответствующими механизмами рассеяния электронов не позволит адекватно моделировать функционирование такого рода транзисторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jacoboni, C. The Monte Carlo method for semiconductor device simulation / C. Jacoboni, P. Lugli. Wien – New York: Springer – Verlag, 1989. 356 p.
2. Monte Carlo device simulation: full band and beyond / ed. by K. Hess. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991. 310 p.
3. Борзов, В. М. Моделирование методом Монте-Карло приборных структур интегральной электроники / В. М. Борзов, О. Г. Жевняк, Ф. Ф. Комаров, В. О. Галенчик. Мин.: БГУ, 2007. 175 с.
4. Vasileska, D. The role of quantization effects on the operation of 50 nm MOSFETs, 250 nm FIBMOS devices // Physica status solidi (b). 2002. Vol. 233. No. 1. P. 127–133.
5. Vasileska, D. The role of quantization effects on the operation of 50 nm MOSFETs, 250 nm FIBMOS devices and narrow-width SOI device structures / D. Vasileska [et al.] // Journal of computational electronics. 2002. No. 1. P. 453–465.
6. Kaiblanger-Grujin, G. Influence of the doping element on the electron mobility in n-silicon / G. Kaiblanger-Grujin, H. Kosina, S. Selberherr // Journal of applied physics. 1998. Vol. 83. No. 6. P. 3096–3101.